



目 录

1	Intel公司简介	2
2	Flash产品	2
2.1	成熟芯片	2
2.2	基本存储芯片	2
2.2.1	产品特点	2
2.2.2	产品及性能	3
2.2.3	命名规则及订货信息	3
2.3	主流存储芯片	3
2.3.1	产品特点	3
2.3.2	产品及性能	3
2.3.3	命名规则及订货信息	4
2.4	无线存储芯片	4
2.4.1	产品特点	4
2.4.2	产品及特性	5
2.4.3	命名规则及订货信息	7
3	嵌入式CPU及MCU	11
3.1	嵌入式 486 CPU	11
3.1.1	产品特点	11
3.1.2	产品描述	11
3.2	嵌入式 386 CPU	11
3.2.1	产品特点	11
3.2.2	产品描述	11
3.3	嵌入式 186 CPU	12
3.3.1	产品特点	12
3.3.2	产品描述	12
4	网络收发器	13

<http://www.bdtic.com/Intel>



Intel 产品

1 Intel公司简介

Intel 公司是世界上最大的 CPU 生产厂家，也是 FLASH、嵌入式 CPU 和以太网接口芯片的主要供应商。

2 Flash产品

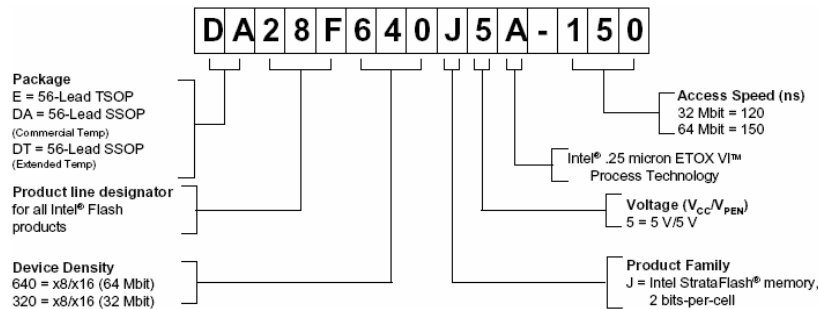
Intel 的 Flash 产品分三个系列：成熟芯片、基本存储芯片、主流存储芯片和无线存储芯片。

2.1 成熟芯片

器件	VCC	密度	数据宽度	速度(ns)	功耗		封装	系列
					Active	Sdandby		
28F320J5	4.5-5.5V	32Mbits	x8/x16	110	30mA	80uA	SSOP	5
28F640J5		64Mbits		130				

<http://www.bdtic.com/Intel>

命名规则及订货信息：



2.2 基本存储芯片

值得依赖的具有最广泛应用的 Flash 芯片。

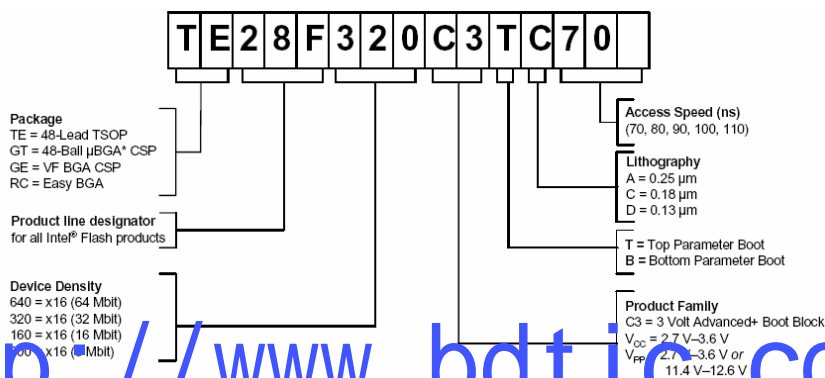
2.2.1 产品特点

- 高性价比 0.18 μm ETOX™ VIII Flash 存储器技术
- 12V V_{pp} 快速编写功能
- -40 °C 到 +85 °C 宽温范围
- 适用于代码和数据存储的优化体系结构

2.2.2 产品及性能

器件	VCC	密度	数据宽度	速度(ns)	功耗		封装	系列
					Active	Sdandby		
28F800/800B3	2.7 V - 3.6 V	8 Mbit	16 位	70,80,90, 100,110	9mA	7uA	TSOP uBGA BGA VF BGA	B3
28F160/160B3		16 Mbit						
28F320B3		32 Mbit						
28F640B3		64 Mbit						
28F800C3		8Mbit						C3
28F160C3		16Mbit						
28F320C3		32Mbit						
28F64C3		64Mbit						

2.2.3 命名规则及订货信息



<http://www.bdtic.com/Intel>

2.3 主流存储芯片

应用于主流代码执行和数据存储的高性价比 Flash 芯片。

2.3.1 产品特点

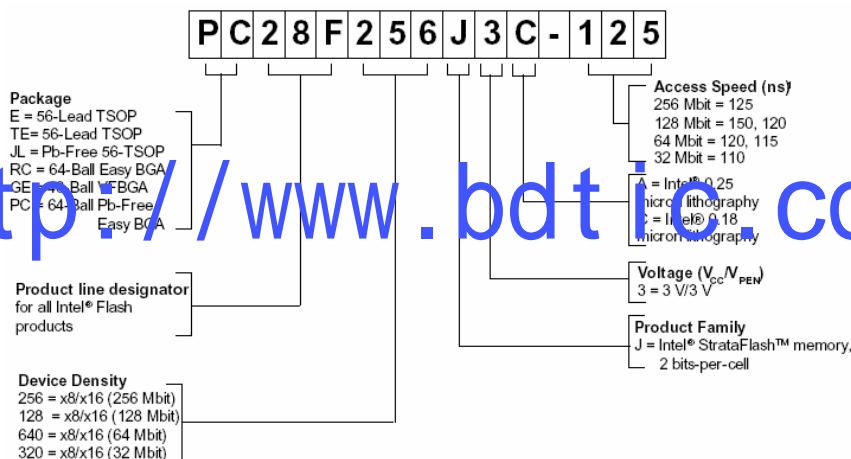
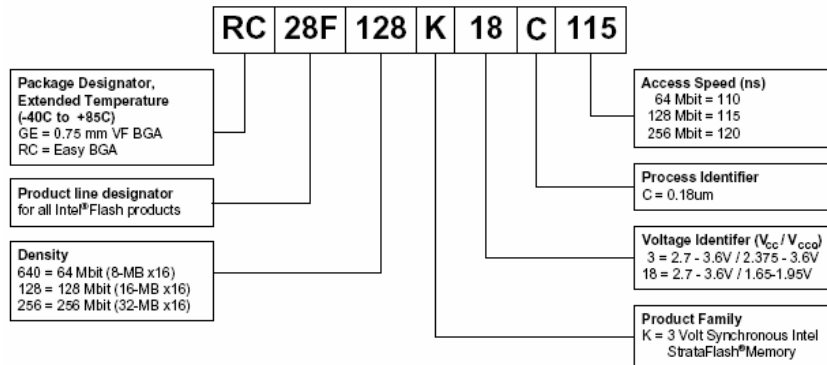
- 支持页面方式的快速访问
- x8/x16 I/O 可配置
- 高性价比 Intel Multi-Level Cell (MLC) 体系结构
- One-Time-Programmable 保护寄存器
- -40 °C 到+85 °C 宽温范围

2.3.2 产品及性能

器件	VCC		密度	数据宽度	速度(ns)	功耗		封装	系列
						Active	Sdandby		
28F256J3	2.7-3.6V	2.7-3.6V	256Mbit	x8/x16	125	10mA	50uA	TSOP BGA VFBGA	J3
28F128J3			128Mbit		150, 120				
28F640J3			64Mbit		120, 115				
28F320J3			32Mbit		110				
28F640K3	2.7-3.6V	2.375-3.6V	64Mbit	16bit	110	10mA	30uA	BGA VF	K3
28F128K3			128Mbit		115				

28F256K3			256Mbit		120			BGA	
28F640K18			64Mbit		110				
28F128K18		1.65-1.95V	128Mbit		115				K18
28F256K18			256Mbit		120				

2.3.3 命名规则及订货信息



<http://www.bdtic.com/Intel>

2.4 无线存储芯片

应用于无线代码执行和数据存储的领先的 Flash 芯片。

2.4.1 产品特点

- 在单一封装中提供由代码执行、数据存储和 RAM 功能的系统解决方案
- 简单的引脚和软件提供简单的升级通道
- 高性价比数据存储
- 0.13 μm 处理工艺
- 1.8 V 工作电压
- 适用于高可靠操作的第四代 MLC 结构
- 工作温度: -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$ 或 -25°C to $+85^{\circ}\text{C}$

2.4.2 产品及特性

L18/L30 及 W18/W30 系列:

器件	VCC	密度	数据宽度	速度(ns)	功耗		封装	系列
					Active	Sdandby		
28F640L18	1.7 V - 2.0 V	64Mbit	16 位	85, 95	17mA	25uA	VF BGA	L18
28F128L18		128Mbit						
28F256L18		256Mbit						
28F640L30	1.7 V - 2.0 V	64Mbit	16 位	85, 110	17mA	30uA	VF BGA	L30
28F128L30		128Mbit						
28F256L30		256Mbit						
28F640W18	1.7 V - 1.95 V	64Mbit	16 位	60, 80	8mA	4uA	VF BGA QUAD+	W18
28F128W18		128Mbit						
28F256W18		256Mbit						
28F640W30	1.7 V - 1.95 V	64Mbit	16 位	60, 85	8mA	7uA	VF BGA QUAD+ uBGA	W30
28F320W30		128Mbit						
28F128W30		256Mbit						

L18/L30 SCSP 系列:

器件	产品组成	访问时间 (ns)	封装	Vcc	Vpp/Vpen	V (I/O)	系列
48F3300L0	128L18/128L18	85	RD 80	1.7-2.0V	0.9-2.0V or 9V	1.7-2.0V	L18
48F3300L0	128L30/128L30	85	RD 80	1.7-2.0V	0.9-2.0V or 9V	2.2-3.3V	L30
38F3040L0	128L18/32P	85	RD 80	1.7-2.0V	0.9-2.0V or 9V	1.8-1.95V	L18
38F3040L0	128L30/32P	85	RD 80	1.8-2.0V	0.9-2.0V or 9V	2.7-3.1V	L30
48F4400L0	256L18/256L18	85	LZ 80	1.8-2.0V	0.9-2.0V or 9V	1.7-2.0V	L18
48F4400L0	256L30/256L30	85	LZ 80	1.8-2.0V	0.9-2.0V or 9V	2.2-3.3V	L30

38F4050L0	256L18/64P	85	LZ 80	1.8-2.0V	0.9-2.0V or 9V	1.8-2.0V	L18
38F3350LL	128L30/128L30/64P	85	RD 80	1.7-2.0V	0.9-2.0V or 9V	2.7-3.1V	L30
38F3340LL	128L18/128L18/32P	85	RD 80	1.7-2.0V	0.9-2.0V or 9V	1.8-1.95V	L18

LV18/LV30 SCSP 系列:

器件	产品组成	访问时间 (ns)	封装	Vcc	Vpp/Vpen	V (I/O)	系列
48F4040LV	256L18/256V18	85/170	LZ 80	1.8-2.0V	0.9-2.0V or 9V	1.7-2.0V	LV18
48F4040LV	256L30/256V30	85/170	LZ 80	1.8-2.0V	0.9-2.0V or 9V	2.2-3.3V	LV30
58F0010LV	256L30/256V30/64P/64P/8S	85/170	LZ 80	1.8-2.0V	0.9-2.0V or 9V	2.7-3.1V	LV30

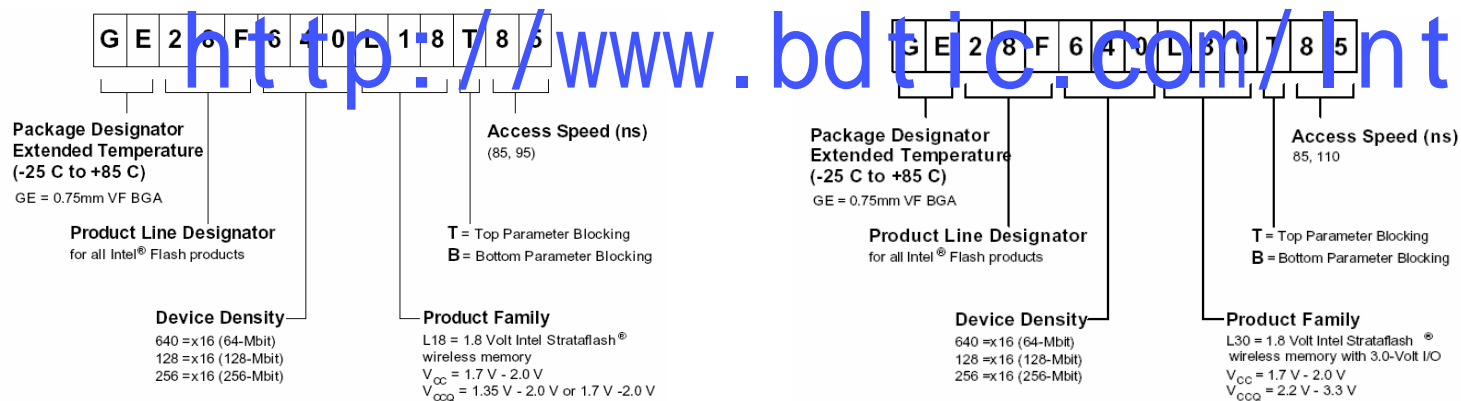
W18/W30 SCSP 系列:

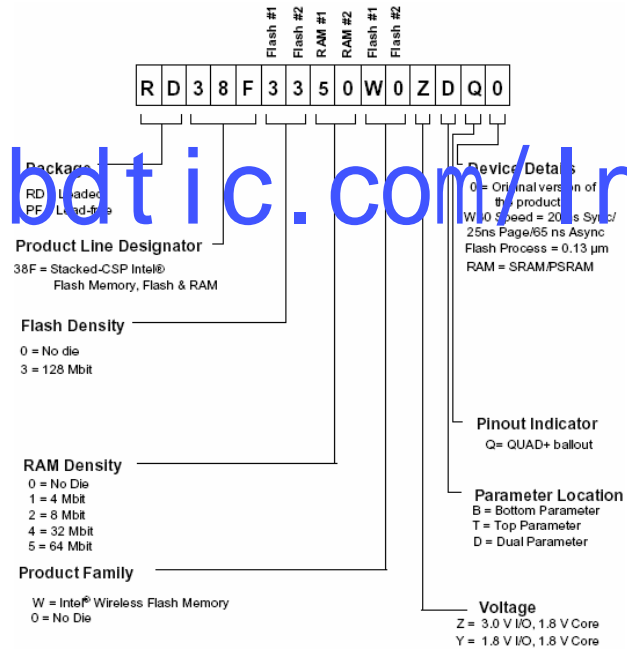
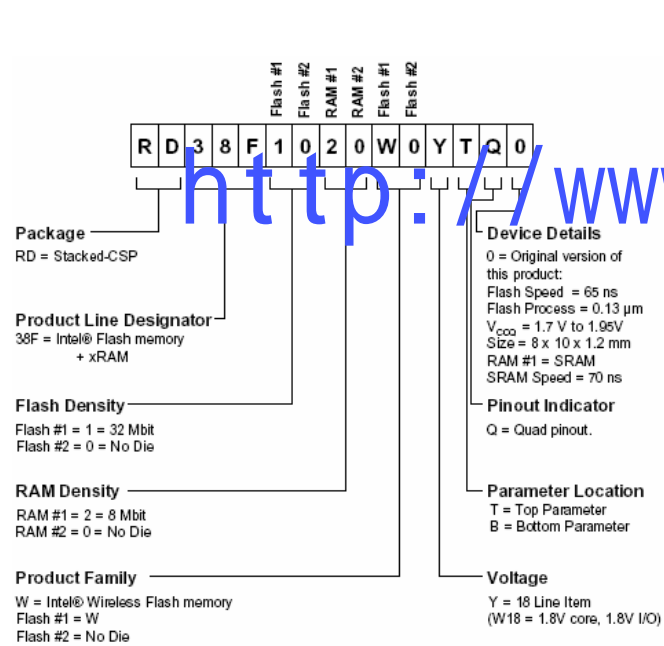
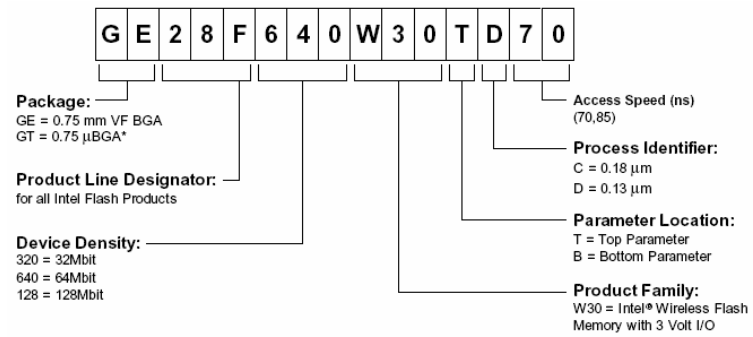
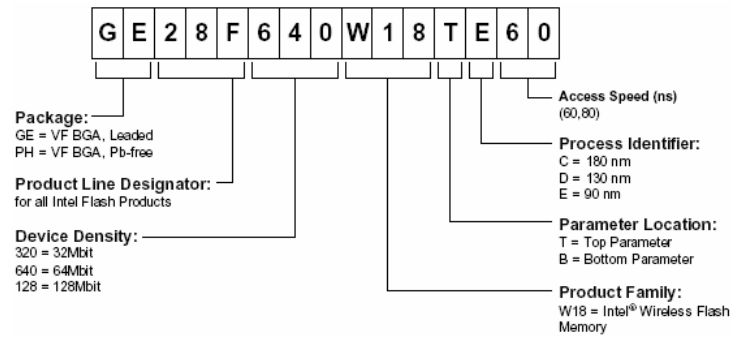
器件	产品组成	访问时间 (ns)	封装	Vcc	Vpp/Vpen	V (I/O)	系列
38F1020W0	32W18/8S	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
38F2020W0	64W18/8S	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
38F2020W0	64W30/8S	70	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.2-3.3V	W30
38F1010W0	32W18/4S	65	RD 58	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
48F2000W0	64W30/0	70	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.2-3.3V	W30
38F2010W0	64W18/4S	65	RD 60	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
38F2010W0	64W18/4S	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
38F2020W0	64W18/8S	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
38F2030W0	64W18/16S	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
38F2030W0	64W30/16S	70	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.2-3.3V	W30
38F2030W0	64W30/16P	70	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.7-3.1V	W30
38F2040W0	64W18/32P	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.8-1.95V	W18
38F2040W0	64W30/32P	70	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.7-3.1V	W30

48F2100W0	64W18/32W18	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
48F2200W0	64W18/64W18	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
38F2230WW	64W18/64W18/16S	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.7-1.95V	W18
38F2230WW	64W30/64W30/16S	70	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.2-3.3V	W30
38F2240WW	64W30/64W30/32P(70ns)	70	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.7-3.1V	W30
38F2240WW	64W18/64W18/32P(88ns)	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	1.8-1.95V	W18
38F2240WW	64W30/64W30/32P(85ns)	70	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.7-3.1V	W30
48F3000W0	128W30/0	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.2-3.3V	W30
38F3350WW	128W30/128W30/64P	65	RD 80	1.7-1.95V	0.9-1.95V or 12V	2.7-3.1V	W30

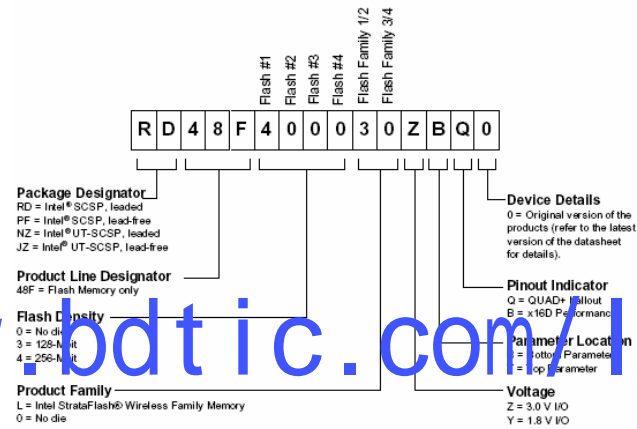
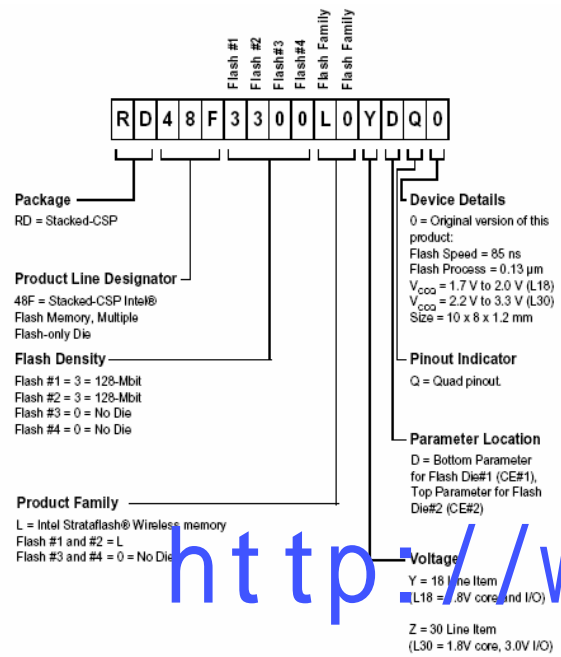
封装说明: **GE** = 0.75mm VF BGA; **RD** = Intel® Stacked Chip Scale Package; **LZ** = Intel® UT-Stacked Chip Scale Package

2.4.3 命名规则及订货信息





<http://www.bdtic.com/Intel>



<http://www.bdtic.com/Intel>

<http://www.bdtic.com/Intel>

3 嵌入式CPU及MCU

3.1 嵌入式 486 CPU

3.1.1 产品特点

- 32 位体系结构
- Intel SL 技术
- 静态核心技术
- 系统管理模式
- Burst 总线数据

3.1.2 产品描述

器件	速度 (MHz)	核心速度 Mult	CACHE	电压	封装	工作温度
80486DX4 32-bit bus	100	3X Clk	16Kb, WB	3.3V	A168 FC208	C
80486DX2 32-bit bus	50, 66	2X Clk	8Kb, WT	5.0V-3.3V	A168, SB208	C
80486SX 32-bit bus	33	N/A	8Kb, WT	5.0V	A168, KU196	C
80486SXSXSF 32-bit bus	33	N/A	8Kb, WT	3.3V	FA176	C
80486CSXSXSF 16-bit bus	33	N/A	8Kb, WT	3.3V	FA176	C

3.2 嵌入式 386 CPU

3.2.1 产品特点

- 32 位体系结构
- 支持商用和宽温系列

3.2.2 产品描述

器件	速度 (MHz)	电压	Statio 设计	地址 空间	封装	工作 温度	其他特性
80386EXTB	25	3.3V	Yes		KU132, FA144	E	A20 Gate, 8CS, WDT, 含 8259A, DRAM 刷新
80386EXTC	25	5.0V	Yes		KU132, FA144	E	
80386EXTC	33	5.0V	Yes		KU132, FA144	E	
80386SX	20,25,33	5.0V	No	16M	NG100	C	TTL 输入
80386DX	20,25,33	5.0V	No	4G	A132, NG132	C	

80386SXTA	25,33,40	5.0V	Yes	16	KU100	C, E	
-----------	----------	------	-----	----	-------	------	--

3.3 嵌入式 186 CPU

3.3.1 产品特点

- 16 位体系结构
- CHMOS, 8-和 16-bit 扩展总线
- 3 个定时计数器
- 1M 寻址空间
- DRAM 刷新

3.3.2 产品描述

器件	速度 (MHz)	IO	串口	DMA 通道	电源选择	片选	电压	封装	工作温度	其他特性
80C186XL/188XL	25	0	No	2	PS	13	5.0V	A68, N68, R68, S80, SB80	C	TTL 输入 CMOS 输入 中断控制器
80C186XL/188XL	12, 20	0	No	2	PS	13	5.0V	A68, N68, R68, S80, SB80*	C, E	
80C186EA/188EA	25	0	No	2	PS, PD, I	13	5.0V	N68	C	
80C186EA/188EA	13, 20	0	No	2	PS, PD, I	13	5.0V	N68	E	
80L186EA/188EA	13	0	No	2	PS, PD, I	13	3.0V	N68	E	
80C186EB/188EB	25	16	2	0	PD, I	10	5.0V	N84, S80, SB80	C	
80C186EB/188EB	13, 20	16	2	0	PD, I	10	5.0V	N84, S80, SB80	E	
80L186EB/188EB	16	16	2	0	PD, I	10	2.9-3.3V	N84, S80, SB80	C	
80L186EB/188EB	13	16	2	0	PD, I	10	2.9-3.3V	N84, S80, SB80	E	
80C186EC/188EC	25	22	2	4	PS, PD, I	10	5.0V	KU100, S100, SB100	C	
80C186EC/188EC	13, 20	22	2	4	PS, PD, I	10	5.0V	KU100, S100, SB100	E	
80L186EC/188EC	16	22	2	4	PS, PD, I	10	3.3V	KU100, S100, SB100	E	
80L186EC/188EC	13	22	2	4	PS, PD, I	10	3.3V	KU100, S100, SB100	E	

<http://www.bdtic.com/Intel>

4 网络收发器

Intel 提供广泛的低功耗、高性能的以太网收发器系列产品，包括 10-BASE-T、快速以太网和千兆以太网收发器。（所有的 10-BASE-T、快速以太网收发器的工作温度为 0° -70° C）

器件	端口	接口	供电	封装	特性
10BASE-T Transceivers					
LXT908	TP & AUI	7-pin MAC 接口，自动 AUI/RJ45 选择	3.3V	44 PLCC 64 LQFP	4 LED 驱动, 宽温, SQE 禁止
LXT907A	TP & AUI	7-pin MAC 接口，自动 AUI/RJ45 选择	3.3V	44 PLCC 64 LQFP	4 LED 驱动, SQE 禁止
LXT907	TP & AUI	7-pin MAC 接口，自动 AUI/RJ45 选择	5V	44 PLCC	4 LED 驱动, SQE 禁止
LXT905	TP	7-pin MAC 接口，自动 AUI/RJ45 选择	3.3V or 5V	28 PLC 32 LQFP	4 LED 驱动,
LXT901A	TP & AUI	7-pin MAC 接口，自动 AUI/RJ45 选择	3.3V	44 PLCC 64 LQFP	4 LED 驱动, 150W STP 选择
LXT901	TP & AUI	7-pin MAC 接口，自动 AUI/RJ45 选择	5V	44 PLCC 64 LQFP	4 LED 驱动, 150W STP 选择
Fast Ethernet Transceivers					
LXT9785E	8 TP 或 光纤	RMI/SMII/SS-SMII (2.5V/3.3V)	2.5V	241 PBGA 208 PQFP	增强型 IP 电话特性, DT discovery, 自动 MDI/MDIX
LXT9785	8 TP 或 光纤	RMI/SMII/SS-SMII (2.5V/3.3V)	2.5V	241 PBGA 208 PQFP	超低功耗, 自动 MDI/MDIX, MDIO sectionalization, robust CDE 保护
LXT9784	8 TP	RMI/SMII/SS-SMII (2.5V/3.3V)	2.5V	208 PQFP	Auto MDI/MDIX,
LXT9763	6 TP 或 光纤	MII	3.3V	208 PQFP	Robust CDE protection
LXT975	4 TP 或 2 光纤和 2 TP	MII	5V	160 PQFP	优化 stacked RJ-45 连接器
LXT974	4 TP 或 光纤	MII	5V	160 PQFP	
LXT973	2 TP 或 光纤	每端口独立 MII	2.5V	100 PQFP	自动 MDI/MDIX, CDE tolerance,
LXT972A	TP	MII, MDIO/MDINT, 硬件控制	3.3V	64 LQFP	3 LED 驱动, 可编程 LEDs, CDE 保护, JTAG boundary scan, baseline wander correction, 低功耗
LXT971A	TP 或 光纤	MII, MDIO/MDINT, 硬件控制	3.3V	64 PBGA 64 LQFP	3 LED 驱动, 可编程 LEDs, CDE 保护, JTAG boundary

					scan, baseline wander correction,
LXT970A	TP 或 光纤	MII, MDIO/MDINT, 硬件控制	5V	64 TQFP 64 PQFP	5 LED 驱动, baseline wander correction

<http://www.bdtic.com/Intel>